

NC259FPA SOLDADURA EN PASTA ULTRAFINA NO CLEAN

CARACTERÍSTICAS

- Definición de impresión precisa con polvo de aleación de tipo 6 y menores
- Excelente humectación/alta resistencia al cizallamiento
- Claro residuo de flux
- Se recomienda reflujo con nitrógeno
- Sin halógenos
- Vida útil de 8 horas

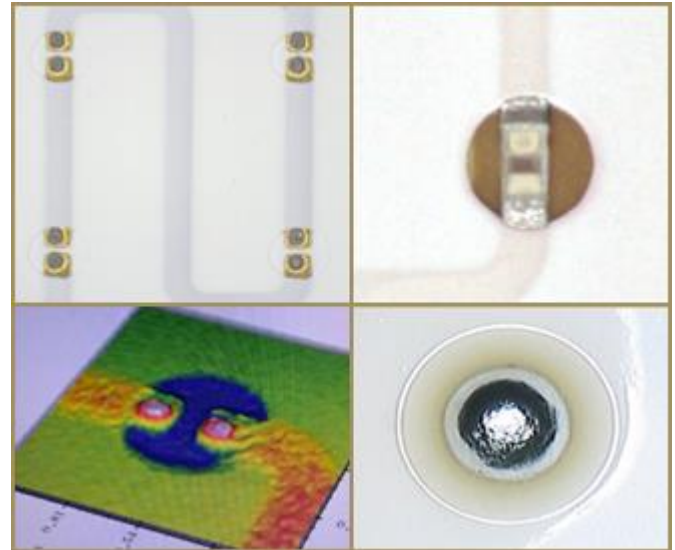
DESCRIPCIÓN

La soldadura en pasta NC259FPA de AIM se ha desarrollado para su uso con soldadura en polvo de tipo 6 y más fina. NC259FPA demuestra una alta eficiencia de transferencia y una definición de impresión precisa. El sistema activador NC259FPA promueve la humectación en todos los acabados de superficie, lo que resulta en valores de cizallamiento de hasta 150 gf. El residuo de NC259FPA tiene altos valores SIR y es transparente al agua. NC259FPA proporciona alta fuerza de adherencia, necesaria para el montaje por transferencia de masa.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

PARÁMETRO	TIEMPO	TEMPERATURA
Vida útil en refrigeración	6 meses	0°C - 12°C (32°F - 55°F)
Vida útil sin refrigeración	2 semanas	< 25°C (< 77°F)

NC259FPA debe consumirse en las 24 horas después de romper el sello del envase. La pasta puede permanecer en la impresora durante 6-8 horas. No añada pasta usada a la que no se haya utilizado. Almacene la pasta usada por separado; mantenga la pasta no usada bien cerrada con el tapón interno o la tapa en su sitio. Consulte el certificado de análisis NC259FPA para obtener información específica sobre el producto. Encontrará recomendaciones adicionales de manipulación en: https://aimsolder.com/sites/default/files/aim_paste_handling_guideline_revfnfl.pdf.



LIMPIEZA

Pre-reflujo: El limpiador de estenciles de AIM elimina eficazmente la soldadura en pasta de los estenciles durante el proceso. El limpiador de estenciles se puede aplicar a mano o utilizar en equipos de limpieza bajo estencil. El limpiador de estenciles no seca la soldadura en pasta y mejora las propiedades de transferencia. No aplique una cantidad excesiva de limpiador de estenciles. No aplique el limpiador de estenciles en la parte superior del estencil. No se recomienda el uso de isopropanol (IPA) durante el proceso, pero se puede utilizar como enjuague final del estencil.

Residuos de flux posteriores al reflujo: Pueden quedar residuos en el ensamblaje después del reflujo, pero no es necesario limpiarlos. Cuando la limpieza es obligatoria, AIM ha colaborado estrechamente con socios del sector para garantizar que los residuos se puedan eliminar eficazmente con agentes desfluxantes comunes. Póngase en contacto con AIM para obtener información sobre la limpieza.

PERFIL DE REFLUJO

Encontrará información detallada sobre el perfil en <http://www.aimsolder.com/reflow-profile-supplements>. Para más información, póngase en contacto con un representante de AIM.

*All information for reference only. Not to be used as incoming product specifications or for process design. Consult Certificate of Analysis for product specific information.

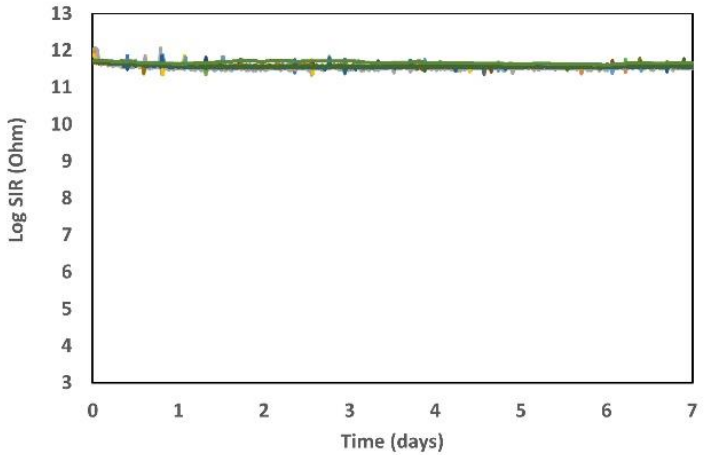
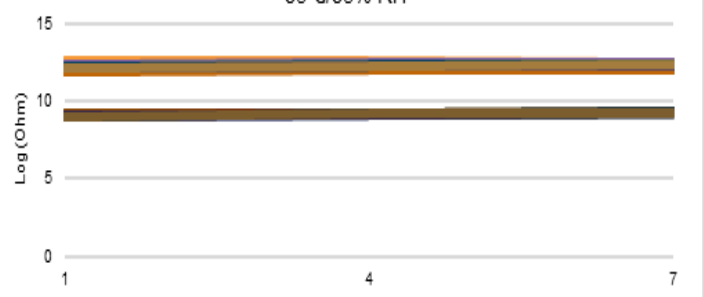
DISCLAIMER The information contained herein is based on data considered accurate and is offered at no charge. Product information is based upon the assumption of proper handling and operating conditions. Liability is expressly disclaimed for any loss or injury arising out of the use of this information or the use of any materials designated. Please refer to <http://www.aimsolder.com/terms-conditions> to review AIM's terms and conditions.

DATOS DE PRUEBA

NOMBRE	MÉTODO DE PRUEBA	RESULTADOS	
Clasificación IPC de Flux	J-STD-004 versión actual	ROL0	
NOMBRE	MÉTODO DE PRUEBA	RESULTADOS TÍPICOS	IMAGEN
Espejo de Cobre	J-STD-004C 3.3.1.1 IPC-TM-650 2.3.32	Ningún avance Bajo	 <p>Paste Control</p>
Corrosión	J-STD-004C 3.3.1.2 IPC-TM-650 2.6.15	No corrosión Bajo	<p>Después de 10 días de incubación</p> 
Haluros cuantitativos	J-STD-004C 3.3.1.3 IPC-TM-650 2.3.28.1	<0.05% Bajo	
Cualitativa Haluros, Cromato de Plata	J-STD-004C 3.4.1.1 IPC-TM-650 2.3.33	PASA	
Cualitativa Haluros, Fluoruro Punto	J-STD-004C 3.4.1.2 IPC-TM-650 2.3.35.1	PASA	
Contenido de Halógenos	EN 14582	PASA	Libre de Halógenos

*All information for reference only. Not to be used as incoming product specifications or for process design. Consult Certificate of Analysis for product specific information.

DISCLAIMER The information contained herein is based on data considered accurate and is offered at no charge. Product information is based upon the assumption of proper handling and operating conditions. Liability is expressly disclaimed for any loss or injury arising out of the use of this information or the use of any materials designated. Please refer to <http://www.aimsolder.com/terms-conditions> to review AIM's terms and conditions.

NOMBRE	MÉTODO DE PRUEBA	TÍPICO RESULTS	IMAGE
Resistencia Aislante de la Superficie	J-STD-004 Actual Rev. IPC-TM-650 2.6.3.7	No-clean state \geq 100 M Ω Bajo	<p>40°C/ 90%RH</p> 
Resistencia Aislante de la Superficie	J-STD-004 Actual Rev. IPC-TM-650 2.6.3.3	No-clean state \geq 100 M Ω Low	<p>85°C/85% RH</p> 
Determinación de Sólidos de flux, no volátiles	J-STD-004C 3.3.2.1 IPC-TM-650 2.3.34	74% de contenido de sólidos	
Determinación Valor Ácido	J-STD-004 Actual Rev. TM-650 2.3.13	174.2 mg KOH /g	
Viscosidad (Malcom)	J-STD-005A 3.5.1 IPC-TM-650 2.4.34	170-210 PaS* Típico	* En función de la fórmula
Visual	J-STD-004C 3.3.2.5	PASA	
Prueba de Slump	J-STD-005A 3.6 IPC-TM-650 2.4.35	PASA	
Fuerza de adhesión	JIS standard Z 3284	120 gf Típico	* En función de la fórmula

*All information for reference only. Not to be used as incoming product specifications or for process design. Consult Certificate of Analysis for product specific information.

DISCLAIMER The information contained herein is based on data considered accurate and is offered at no charge. Product information is based upon the assumption of proper handling and operating conditions. Liability is expressly disclaimed for any loss or injury arising out of the use of this information or the use of any materials designated. Please refer to <http://www.aimsolder.com/terms-conditions> to review AIM's terms and conditions.